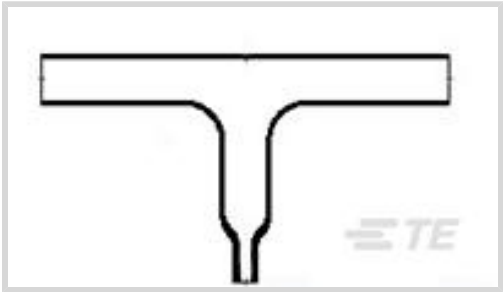




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: T 形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 50

材料系统代码: 30

粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	T 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	50
材料系统代码	30

尺寸

内径范围（支脚 2）	5.1 – 12.7 mm[.2 – .5 in]
内径范围（支脚 1）	11.4 – 22.9 mm[.45 – .9 in]
内径范围（主体）	11.4 – 34.3 mm[.45 – 1.35 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期浸泡

操作/应用

机械阻力	液体
------	----



其他

模制部件形状代码	322C
尺寸代码	512
粘合剂代码	S1125

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了



文档

[322C512-50-0](#)

英文版本

[1654025_Sec4_-50](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

[Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable](#)

英文版本